

Prensa Caliente Al Vacío De 25 Toneladas 200X200Mm Con Control Programable P-T-T

Número de artículo: XP26



Introducción

Diseñada para aplicaciones de laboratorio exigentes, esta prensa caliente al vacío de sobremesa de 25 toneladas proporciona sincronización precisa P-T-t, rango de temperatura de hasta 500 °C, atmósfera de gas inerte/vacío y coincidencia adaptativa de potencia, lo que permite la sinterización y unión de alta densidad en investigación de baterías de estado sólido, cerámicas y materiales compuestos. Sistema compacto certificado por CE con reducción dinámica de presión para una fiabilidad a largo plazo.

[Aprende más](#)

| Aplicación | Descripción | Beneficio Clave |
|--------------------------------------|---|--|
| I+D en Baterías de Estado Sólido | Densificación y unión de interfaz sólido-sólido de electrolitos de sulfuro/óxido a alta temperatura y presión. | La alta hermeticidad de la cámara permite la sinterización con retención de presión a largo plazo bajo N ₂ /Ar, evitando la oxidación del litio activo. |
| Cerámicas Avanzadas y Compuestos | Sinterización por difusión al vacío sin oxígeno de polvos cerámicos y compuestos de matriz no metálica. | La cámara de acero inoxidable SUS304 con vacío de -0,1 MPa elimina rápidamente los gases volátiles para obtener componentes sin defectos. |
| Electrónica Flexible y MLCC | Laminación caliente por pasos múltiples de películas poliméricas y condensadores cerámicos multicapa con capas delicadas. | La presión de arranque suave programable de tan solo 100 g evita la fractura de láminas delgadas quebradizas durante el prensado inicial. |
| Unión por Difusión de Metales | Soldeo por difusión atómica de metales/aleaciones disímiles al vacío a alta temperatura. | Las placas rectificadas de 200x200 mm con alto paralelismo garantizan una distribución uniforme de tensión, minimizando huecos y defectos. |
| Compactación en Metalurgia de Polvos | Consolidación de alta densidad de polvos metálicos, cerámicos y compuestos al vacío. | Elimina los gases atrapados, reduce la porosidad y mejora la resistencia mecánica y la conductividad eléctrica. |

| Parámetro | Configuración Estándar | Configuración Profesional/Actualizada |
|--------------------------------------|--|--|
| Tamaño de la Placa | 200 x 200 mm | - |
| Temperatura Máxima | 300 °C (enfriamiento natural) | 500 °C (requiere enfriador de recirculación) |
| Precisión del Control de Temperatura | ≤ 3 °C | ≤ 1 °C |
| Velocidad Máxima de Calentamiento | ≤ 3 °C/min | - |
| Presión Máxima (Estado Frío) | 25 Toneladas (250 kN) | - |
| Presión Máxima (Estado Caliente) | - | 15 Toneladas (150 kN) @ 500°C |
| Precisión del Control de Presión | ±0,1 Toneladas (retroalimentación en lazo cerrado) | - |
| Abertura de Luz | 50 mm | 100 mm (adecuado para moldes grandes) |
| Potencia de Calentamiento | 1800 W / 2400 W | 3000 W / 3500 W |

| Parámetro | Configuración Estándar | Configuración Profesional/Actualizada |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Tamaño de la Cámara de Vacío | - | 400 × 400 × 400 mm |
| Material de la Cámara | Acero Inoxidable SUS 304 | - |
| Vacío Máximo | -0,1 MPa (con bomba de doble etapa de 240 L/min) | - |
| Método de Enfriamiento de la Placa | Aire ambiente | Enfriador de recirculación externo |
| Interfaz de Control | Pantalla táctil PLC programable de 7 pulgadas | - |
| Opciones de Suministro Eléctrico | AC 220 V / 50 Hz | AC 110 V / 60 Hz o AC 440 V / 60 Hz |
| Peso Neto (aprox.) | 270 kg (varía según configuración) | - |
| Cumplimiento | Certificado CE | - |